

# Webcast

## Componentes superficiales y su manejo térmico

### Descripción

Hemos observado con el transcurrir del tiempo la evolución de los componentes de montaje superficial, especialmente en aplicadores de potencia más robustos que exigen una mejor administración térmica no solo desde el punto de vista del funcionamiento, también en las técnicas de diseño y ensamblaje. <div><br></div><div>Pensemos en que esta evolución nos ha permitido tener componentes con niveles altos en el montaje de potencia y con la gran ventaja de usarlos dentro de circuitos impresos sin la necesidad de aislarlos o usar conexiones externas a través de cables o conectores, todo desarrollado desde el enfoque IPC tradicional. </div>

### Dirigido a

Ingenieros, diseñadores, maestros, investigadores y estudiantes interesados en el uso y conocimiento de las herramientas diseño avanzadas para el campo de la electrónica.

### Objetivo

Desarrollar a través de conceptos físicos y matemáticos, una metodología sencilla que nos permita desarrollar circuitos impresos de potencia con la participación de elementos de montaje superficial con alto manejo de potenci

### Temario

- Breve repaso de conceptos térmicos para el desarrollo de circuitos impresos.
- Desempeño térmico en PCB y dispositivos de potencia.
- Desarrollo de la placa

### Instructores

Gerson David Cruz Capador

Ingeniero Electrónico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; Maestrante en Ingeniería Electrónica y de Computadores de la Universidad de los Andes. Amplia experiencia como ingeniero de desarrollo electrónico en empresas de los sectores aeroespacial y petrolero. Docente universitario en Ingeniería Electrónica y Mecatrónica en el área de sistemas embebidos y electrónica, instructor especializado en herramientas de desarrollo electrónico e instructor especializado de Maple para Latinoamérica.

## Información General

### Duración

1 hora

### Fecha de Inicio

Mie. 22 de Ago de 2018

### Horarios

10:00 a.m San José de Costa Rica

11:00 a.m CDMX - Bogotá - Quito - Lima

12:00 a.m La Paz - Santiago - Caracas

01:00 p.m Buenos Aires

## Herramientas de apoyo



### Políticas

Para conocer en detalle las condiciones y políticas de participación en los eventos, ingrese a nuestro link <https://www.software-shop.com/formacion/politicas>

Inscríbete ahora